

# 2022-2028年中国高端芯片 市场评估与未来前景预测报告

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

[www.cction.com](http://www.cction.com)

## 一、报告报价

《2022-2028年中国高端芯片市场评估与未来前景预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202206/304712.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2022-2028年中国高端芯片市场评估与未来前景预测报告》共十五章。首先介绍了高端芯片行业市场发展环境、高端芯片整体运行态势等，接着分析了高端芯片行业市场运行的现状，然后介绍了高端芯片市场竞争格局。随后，报告对高端芯片做了重点企业经营状况分析，最后分析了高端芯片行业发展趋势与投资预测。您若想对高端芯片产业有个系统的了解或者想投资高端芯片行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

### 第一章 高端芯片行业相关概述

#### 1.1 芯片相关介绍

##### 1.1.1 基本概念

##### 1.1.2 摩尔定律

##### 1.1.3 芯片分类

##### 1.1.4 产业链条

##### 1.1.5 商业模式

#### 1.2 高端芯片相关概述

##### 1.2.1 高端概念界定

##### 1.2.2 高级逻辑芯片

##### 1.2.3 高级存储芯片

##### 1.2.4 高级模拟芯片

##### 1.2.5 芯片进程发展

### 第二章 2016-2020年国际高端芯片行业发展综合分析

#### 2.1 2016-2020年全球芯片行业发展情况分析

##### 2.1.1 全球经济形势分析

##### 2.1.2 全球芯片销售规模

- 2.1.3 全球芯片区域市场
- 2.1.4 全球芯片产业分布
- 2.1.5 芯片细分市场结构
- 2.1.6 全球芯片需求现状
- 2.1.7 芯片市场龙头企业
- 2.2 2016-2020年全球高端芯片行业现况分析
  - 2.2.1 高端芯片市场现状
  - 2.2.2 高端逻辑芯片市场
  - 2.2.3 高端存储芯片市场
- 2.3 2016-2020年美国高端芯片行业发展分析
  - 2.3.1 美国芯片发展现状
  - 2.3.2 美国芯片市场结构
  - 2.3.3 美国主导芯片供应
  - 2.3.4 芯片行业政策战略
- 2.4 2016-2020年韩国高端芯片行业发展分析
  - 2.4.1 韩国芯片发展现状
  - 2.4.2 韩国芯片市场分析
  - 2.4.3 韩国芯片发展问题
  - 2.4.4 芯片发展经验借鉴
- 2.5 2016-2020年日本高端芯片行业发展分析
  - 2.5.1 日本芯片市场现状
  - 2.5.2 芯片材料设备优势
  - 2.5.3 日本芯片国家战略
  - 2.5.4 日本芯片发展经验
- 2.6 2016-2020年中国台湾高端芯片行业发展分析
  - 2.6.1 中国台湾芯片发展现状
  - 2.6.2 中国台湾芯片市场规模
  - 2.6.3 芯片产业链布局分析
  - 2.6.4 台湾与大陆产业优势互补
  - 2.6.5 美国对台湾芯片发展影响

### 第三章 2016-2020年中国高端芯片行业发展环境分析

- 3.1 政策环境
  - 3.1.1 智能制造行业政策
  - 3.1.2 行业监管主体部门
  - 3.1.3 行业相关政策汇总
  - 3.1.4 集成电路税收政策
- 3.2 经济环境
  - 3.2.1 宏观经济概况
  - 3.2.2 对外经济分析
  - 3.2.3 工业经济运行
  - 3.2.4 固定资产投资
  - 3.2.5 宏观经济展望
  - 3.2.6 中美科技战影响
- 3.3 投融资环境
  - 3.3.1 美方制裁加速投资
  - 3.3.2 社会资本推动作用
  - 3.3.3 大基金投融资情况
  - 3.3.4 地方政府产业布局
  - 3.3.5 设备资本市场情况
- 3.4 人才环境
  - 3.4.1 需求现状概况
  - 3.4.2 人才供需失衡
  - 3.4.3 创新人才紧缺
  - 3.4.4 培养机制不健全

## 第四章 2016-2020年中国高端芯片行业综合分析

- 4.1 2016-2020年中国芯片行业发展业态
  - 4.1.1 芯片市场发展规模
  - 4.1.2 芯片细分产品业态
  - 4.1.3 芯片设计行业发展
  - 4.1.4 芯片制造行业发展
  - 4.1.5 芯片封测行业发展
- 4.2 2016-2020年中国高端芯片发展情况

- 4.2.1 高端芯片行业发展现状
- 4.2.2 高端芯片细分产品发展
- 4.2.3 高端芯片技术发展方向
- 4.3 高端芯片行业投融资分析
  - 4.3.1 行业投融资态势
  - 4.3.2 行业投融资动态
  - 4.3.3 行业投融资趋势
  - 4.3.4 行业投融资壁垒
- 4.4 高端芯片行业发展问题
  - 4.4.1 芯片产业核心技术不足
  - 4.4.2 产业结构存在恶性循环
  - 4.4.3 资金盲目投入高端芯片
  - 4.4.4 国产高端制造尚未突破
- 4.5 高端芯片行业发展建议
  - 4.5.1 尊重市场发展规律
  - 4.5.2 上下环节全面发展
  - 4.5.3 加强全球资源整合

## 第五章 2016-2020年高性能CPU芯片行业发展分析

- 5.1 CPU芯片相关概述
  - 5.1.1 CPU基本介绍
  - 5.1.2 CPU芯片分类
  - 5.1.3 CPU的指令集
  - 5.1.4 CPU的微架构
- 5.2 高性能CPU芯片技术演变
  - 5.2.1 CPU总体发展概述
  - 5.2.2 指令集更新与优化
  - 5.2.3 微架构的升级过程
- 5.3 CPU芯片市场现状分析
  - 5.3.1 产业链条结构分析
  - 5.3.2 全球高端CPU供需分析
  - 5.3.3 国产高端CPU发展现状

- 5.3.4 国产高端CPU市场前景
- 5.4 CPU芯片细分市场分析
  - 5.4.1 服务器CPU市场
  - 5.4.2 PC领域CPU市场
  - 5.4.3 移动计算CPU市场
- 5.5 CPU行业代表企业CPU产品业务分析
  - 5.5.1 AMD CPU产品分析
  - 5.5.2 英特尔CPU产品分析
  - 5.5.3 苹果CPU产品分析

## 第六章 2016-2020年高性能GPU芯片行业发展分析

- 6.1 GPU芯片基本介绍
  - 6.1.1 GPU概念阐述
  - 6.1.2 GPU的微架构
  - 6.1.3 GPU的API
  - 6.1.4 GPU芯片显存
  - 6.1.5 GPU芯片分类
- 6.2 高性能GPU芯片演变分析
  - 6.2.1 GPU芯片发展历程
  - 6.2.2 GPU微架构进化过程
  - 6.2.3 先进制造升级历程
  - 6.2.4 主流高端GPU芯片
- 6.3 高性能GPU芯片市场分析
  - 6.3.1 GPU产业链条分析
  - 6.3.2 全球GPU发展现状
  - 6.3.3 全球供需情况概述
  - 6.3.4 国产GPU发展情况
  - 6.3.5 国内GPU企业布局
  - 6.3.6 国内高端GPU研发
- 6.4 GPU芯片细分市场分析
  - 6.4.1 服务器GPU芯片市场
  - 6.4.2 移动GPU芯片市场分析

- 6.4.3 PC领域GPU芯片市场
- 6.4.4 AI领域GPU芯片市场
- 6.5 高性能GPU芯片行业代表企业产品分析
  - 6.5.1 英伟达GPU产品分析
  - 6.5.2 AMD GPU产品分析
  - 6.5.3 英特尔GPU产品分析

## 第七章 2016-2020年FPGA芯片行业发展综述

- 7.1 FPGA芯片概况综述
  - 7.1.1 定义及物理结构
  - 7.1.2 芯片特点与分类
  - 7.1.3 不同芯片的区别
  - 7.1.4 FPGA技术分析
- 7.2 FPGA芯片行业产业链分析
  - 7.2.1 FPGA市场上游分析
  - 7.2.2 FPGA市场中游分析
  - 7.2.3 FPGA市场下游分析
- 7.3 全球FPGA芯片市场发展分析
  - 7.3.1 FPAG市场发展现状
  - 7.3.2 FPGA全球竞争情况
  - 7.3.3 AI领域FPGA的发展
  - 7.3.4 FPGA芯片发展趋势
- 7.4 中国FPGA芯片市场发展分析
  - 7.4.1 中国FPGA市场规模
  - 7.4.2 中国FPGA竞争格局
  - 7.4.3 中国FPGA企业现状

## 第八章 2016-2020年存储芯片行业发展分析

- 8.1 存储芯片发展概述
  - 8.1.1 存储芯片定义及分类
  - 8.1.2 存储芯片产业链构成
  - 8.1.3 存储芯片技术发展



## 8.2 存储芯片市场发展情况分析

### 8.2.1 存储芯片行业驱动因素

### 8.2.2 全球存储芯片发展规模

### 8.2.3 中国存储芯片销售规模

### 8.2.4 国产存储芯片发展现状

### 8.2.5 存储芯片行业发展趋势

## 8.3 高端DRAM芯片市场分析

### 8.3.1 高端DRAM概念界定

### 8.3.2 DRAM芯片产品分类

### 8.3.3 DRAM芯片应用领域

### 8.3.4 DRAM芯片市场现状

### 8.3.5 DRAM市场需求态势

### 8.3.6 企业高端DRAM布局

### 8.3.7 高端DRAM工艺发展

### 8.3.8 国产DRAM研发动态

### 8.3.9 DRAM技术发展潜力

## 8.4 高性能NAND Flash市场分析

### 8.4.1 NAND Flash概念

### 8.4.2 NAND Flash技术路线

### 8.4.3 NAND Flash市场发展规模

### 8.4.4 NAND Flash市场竞争情况

### 8.4.5 NAND Flash需求业态分析

### 8.4.6 高端NAND Flash研发热点

### 8.4.7 国内NAND Flash代表企业

## 第九章 2016-2020年人工智能芯片行业发展分析

### 9.1 人工智能芯片概述

#### 9.1.1 人工智能芯片分类

#### 9.1.2 人工智能芯片主要类型

#### 9.1.3 人工智能芯片对比分析

#### 9.1.4 人工智能芯片产业链

### 9.2 人工智能芯片行业发展情况

- 9.2.1 全球AI芯片市场规模
- 9.2.2 国内AI芯片发展现状
- 9.2.3 国内AI芯片主要应用
- 9.2.4 国产AI芯片厂商分布
- 9.2.5 国内主要AI芯片厂商
- 9.3 人工智能芯片在汽车行业应用分析
  - 9.3.1 AI芯片智能汽车应用
  - 9.3.2 车规级芯片标准概述
  - 9.3.3 汽车AI芯片市场格局
  - 9.3.4 汽车AI芯片国外龙头企业
  - 9.3.5 汽车AI芯片国内龙头企业
  - 9.3.6 智能座舱芯片发展
  - 9.3.7 自动驾驶芯片发展
- 9.4 云端人工智能芯片发展解析
  - 9.4.1 云端AI芯片市场需求
  - 9.4.2 云端AI芯片主要企业
  - 9.4.3 互联网企业布局分析
  - 9.4.4 云端AI芯片发展动态
- 9.5 边缘人工智能芯片发展情况
  - 9.5.1 边缘AI使用场景
  - 9.5.2 边缘AI芯片市场需求
  - 9.5.3 边缘AI芯片市场现状
  - 9.5.4 边缘AI芯片主要企业
  - 9.5.5 边缘AI芯片市场前景
- 9.6 人工智能芯片行业未来发展趋势
  - 9.6.1 AI芯片未来技术趋势
  - 9.6.2 边缘智能芯片市场机遇
  - 9.6.3 终端智能计算能力预测
  - 9.6.4 智能芯片一体化生态发展

## 第十章 2016-2020年5G芯片行业发展分析

### 10.1 5G芯片行业发展分析

- 10.1.1 5G芯片分类
- 10.1.2 5G芯片产业链
- 10.1.3 5G芯片发展历程
- 10.1.4 5G芯片市场需求
- 10.1.5 5G芯片行业现状
- 10.1.6 5G芯片市场竞争
- 10.1.7 5G芯片企业布局
- 10.1.8 5G终端发展情况
- 10.2 5G基带芯片市场发展情况
  - 10.2.1 基带芯片基本定义
  - 10.2.2 基带芯片组成部分
  - 10.2.3 基带芯片基本架构
  - 10.2.4 基带芯片市场现状
  - 10.2.5 基带芯片竞争现状
  - 10.2.6 国产基带芯片发展
- 10.3 5G射频芯片市场发展情况
  - 10.3.1 射频芯片基本介绍
  - 10.3.2 射频芯片组成部分
  - 10.3.3 射频芯片发展现状
  - 10.3.4 射频芯片企业布局
  - 10.3.5 企业产品研发动态
  - 10.3.6 射频芯片技术壁垒
  - 10.3.7 射频芯片市场空间
- 10.4 5G物联网芯片市场发展情况
  - 10.4.1 物联网芯片重要地位
  - 10.4.2 5G时代物联网通信
  - 10.4.3 5G物联网芯片布局
- 10.5 5G芯片产业未来发展前景分析
  - 10.5.1 5G行业趋势分析
  - 10.5.2 5G芯片市场趋势
  - 10.5.3 5G芯片应用前景

## 第十一章 2016-2020年光通信芯片行业发展分析

### 11.1 光通信芯片相关概述

#### 11.1.1 光通信芯片介绍

#### 11.1.2 光通信芯片分类

#### 11.1.3 光通信芯片产业链

### 11.2 光通信芯片产业发展情况

#### 11.2.1 光通信芯片产业发展现状

#### 11.2.2 光通信芯片技术发展态势

#### 11.2.3 光通信芯片产业主要企业

#### 11.2.4 高端光通信芯片竞争格局

#### 11.2.5 高端光通信芯片研发动态

### 11.3 光通信芯片行业投融资潜力分析

#### 11.3.1 行业投融资情况

#### 11.3.2 行业项目投资案例

#### 11.3.3 行业项目投资动态

### 11.4 光通信芯片行业发展趋势

#### 11.4.1 国产替代规划

#### 11.4.2 行业发展机遇

#### 11.4.3 行业发展趋势

#### 11.4.4 产品发展趋势

## 第十二章 2016-2020年其他高端芯片市场发展分析

### 12.1 高精度ADC芯片市场分析

#### 12.1.1 ADC芯片概述

#### 12.1.2 ADC芯片技术分析

#### 12.1.3 ADC芯片设计架构

#### 12.1.4 ADC芯片市场需求

#### 12.1.5 ADC芯片主要市场

#### 12.1.6 高端ADC市场格局

#### 12.1.7 国产高端ADC发展

#### 12.1.8 高端ADC进入壁垒

### 12.2 高端MCU芯片市场分析

- 12.2.1 MCU芯片发展概况
- 12.2.2 MCU市场发展规模
- 12.2.3 MCU市场竞争格局
- 12.2.4 国产高端MCU发展
- 12.2.5 智能MCU发展分析
- 12.3 ASIC芯片市场运行情况
- 12.3.1 ASIC芯片定义及分类
- 12.3.2 ASIC芯片应用领域
- 12.3.3 芯片技术升级现状
- 12.3.4 人工智能ASIC趋势

### 第十三章 国际高端芯片行业主要企业运营情况

#### 13.1 高通

- 13.1.1 企业发展概况
- 13.1.2 企业经营状况分析

#### 13.2 三星

- 13.2.1 企业发展概况
- 13.2.2 企业经营状况分析

#### 13.3 英特尔

- 13.3.1 企业发展概况
- 13.3.2 企业经营状况分析

#### 13.4 英伟达

- 13.4.1 企业发展概况
- 13.4.2 企业经营状况分析

#### 13.5 AMD

- 13.5.1 企业发展概况
- 13.5.2 企业经营状况分析

#### 13.6 联发科

- 13.6.1 企业发展概况
- 13.6.2 企业经营状况分析

### 第十四章 国内高端芯片行业主要企业运营情况

- 14.1 海思半导体
  - 14.1.1 企业发展概况
  - 14.1.2 产品发展分析
  - 14.1.3 服务领域分析
  - 14.1.4 企业营收情况
- 14.2 紫光展锐
  - 14.2.1 企业发展概况
  - 14.2.2 企业主要产品
  - 14.2.3 服务领域分析
  - 14.2.4 企业营收情况
- 14.3 光迅科技
  - 14.3.1 企业发展概况
  - 14.3.2 经营效益分析
  - 14.3.3 业务经营分析
  - 14.3.4 财务状况分析
- 14.4 寒武纪科技
  - 14.4.1 企业发展概况
  - 14.4.2 经营效益分析
  - 14.4.3 业务经营分析
  - 14.4.4 财务状况分析
- 14.5 盛景微电子
  - 14.5.1 企业发展概况
  - 14.5.2 经营效益分析
  - 14.5.3 业务经营分析
  - 14.5.4 财务状况分析
- 14.6 兆易创新
  - 14.6.1 企业发展概况
  - 14.6.2 经营效益分析
  - 14.6.3 业务经营分析
  - 14.6.4 财务状况分析
- 14.7 高端芯片行业其他重点企业发展
  - 14.7.1 长江存储

- 14.7.2 燧原科技
- 14.7.3 翱捷科技
- 14.7.4 地平线

## 第十五章 2022-2028年中国高端芯片产业发展前景预测

- 15.1 芯片行业未来发展趋势
  - 15.1.1 产业增长带动环节突破 ( )
  - 15.1.2 全球化致外部压力严峻
  - 15.1.3 市场竞争加速产业集聚
- 15.2 高端芯片行业应用市场展望
  - 15.2.1 5G手机市场需求强劲
  - 15.2.2 服务器市场保持涨势
  - 15.2.3 PC电脑市场需求旺盛
  - 15.2.4 智能汽车市场稳步发展
  - 15.2.5 智能家居市场快速发展

### 图表目录

- 图表 英特尔Sandy Bridge处理器核心部分
- 图表 CPU关键参数
- 图表 冯若依曼计算机体系
- 图表 CPU对行业的底层支撑
- 图表 CPU架构发展情况
- 图表 台式电脑高端CPU芯片产品及性能
- 图表 2016-2020年第二季度智能手机CPU芯片企业在各区域市场份额
- 图表 手机高端CPU芯片产品及性能
- 图表 主流的高端GPU及其所占据市场
- 图表 全球GPU产业链
- 图表 中国GPU产业链
- 图表 三大存储器芯片对比
- 图表 中国存储器芯片全产业链及内资企业布局
- 图表 中国存储器芯片行业技术发展分析

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202206/304712.html>